

## smt锡膏 锡膏 台锡金属

产品名称	smt锡膏 锡膏 台锡金属
公司名称	广东台锡金属工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇北栅东坊凤凰路40号台锡工业园
联系电话	13058529445

## 产品详情

### 无铅锡膏组装要求

无铅锡膏，并非的禁绝锡膏内铅的存在，而是要求铅含量必须减少到低于1000ppm(<0.1%)的水平，同时意味着电子制造必须符合无铅的组装工艺要求。

“电子无铅化”也常用于泛指包括铅在内的六种有毒有害材料的含量必须控制在1000ppm的水平内。1991和1993年：美国参议院提出将电子焊料中铅含量控制在0.1%以下的要求，遭到美国工业界强烈反对而夭折；1991年起NEMI，smt锡膏，NCMS，NPL，PCIF，ITRI，JIEP等组织相继开展无铅焊料的专题研究，有铅锡膏，耗资超过2000万美元，仍在继续；

### 无卤锡膏有什么特点？

1.不含卤素及其它有害物质。2.印刷流动性好，如IC间距0.4mm都能良好作业。3.焊接残留物，气味小，绝缘阻抗高，不腐蚀线路板，完全达到免清洗的目的。4.可适用不同档次焊接设备的要求，可连续长时间印刷。5.可焊锡好，焊点饱满光亮。因为温度变化会影响助焊剂的性能。湿度太大则可能造成后面锡珠或焊锡的产生！温度太高，锡膏内部的助焊膏会发生作用，无卤锡膏，活性在慢慢的释放，锡膏也在慢慢的变

质，后面会变得很粗甚至结团结块。湿度太大，焊锡膏在印刷的过程中就会有水汽附在其表，积累到一定的程度就会出现诈锡，或者导致锡膏变质。

1998年日本修订家用电子产品再生法，驱使企业界开发无铅电子产品；1998年10月日本松夏公司款批量生产的无铅电子产品问世；2000年6月：美国IPC Lead-Free Roadmap 第4版发表，锡膏，建议美国企业界于2001年推出无铅化电子产品，2004年实现无铅化；无铅锡膏

2000年8月：日本 JEITA Lead-Free Roadmap 1.3

版发表，建议日本企业界于2003年实现标准化无铅电子组装；2002年1月欧盟 Lead-Free Roadmap1.0 版发表，根据问卷调查结果向业界提供关于无铅化的重要统计资料；无铅锡膏

smt锡膏-锡膏-台锡金属由广东台锡金属工业有限公司提供。广东台锡金属工业有限公司为客户提供“焊锡丝,无铅焊锡线,环保锡线厂家,焊锡条”等业务，公司拥有“焊锡丝,无铅焊锡线,环保锡线厂家,焊锡条”等品牌，专注于废金属等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。